

# 2018年合肥高新区促进集成电路产业发展政策部分条款兑现指南

产品名称	2018年合肥高新区促进集成电路产业发展政策部分条款兑现指南
公司名称	合肥卧涛生产力促进中心有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽合肥高新区香樟大道与杨林路交口国信大厦11楼
联系电话	0551-18256501 18755150066

## 产品详情

兑现月底截止！2018年合肥高新区促进集成电路产业发展政策部分条款兑现指南

现将2018年合肥高新区集成电路政策兑现有关事项通知如下：

### 一、企业申报程序

企业登录：

（高新区涉企系统）。点击页面中的登录按钮；如企业已在合创汇平台注册过账号，直接输入账号登录即可，未注册请注册账号后登录，企业在高新区涉企系统首页的“申报通知”栏目中找到半导体投资促进中心发布的相应政策申报通知。进行申报即可（如需要下载申报材料模板，直接点击申报通知模板下载即可），然后点击下面的“我要申报”，即可申报项目。

### 二、申报时间和地点

在线申报时间为2019年10月16日至10月30日，申报单位于10月30日前将纸质材料报送合肥高新区管委会半导体投资促进中心913办公室，逾期不予受理。

### 三、申报内容

（一）鼓励集成电路企业购房、租房（产业政策第5条）

#### 1、申报条件：

（1）在合肥高新区依法从事集成电路设计、制造、封装测试、装备制造、专用材料为主营业务的企业，且经营场所、工商、税务、统计关系均在合肥高新区；

(2) 购买或租用高新集团及其子公司研发和生产用房的高新区企业；

(3) 企业2018、2019年未发生重大安全生产、环保等责任事故。

## 2、购房补贴申报材料：

(1) 办公用房购置补贴申请表（附件1）；

(2) 企业基本情况；

(3) 税务局开具的2018年度企业完税证明；

(4) 企业经第三方审计机构出具的2018年审计报告；

(5) 营业执照；

(6) 购房合同、购房款收据等。

## 3、租房补贴申报材料：

(1) 办公用房房租补贴申请表（附件2）；

(6) 房屋租赁协议、2018年度房租发票等。

### (二) 支持集成电路企业流片及购买IP（产业政策第7条）

(1) 在合肥高新区依法从事集成电路设计为主营业务的企业，且经营场所、工商、税务、统计关系均在合肥高新区；

(2) 2018年企业参保人数原则上不少于5人；

(3) 企业2018年度参加产品光罩、流片及从第三方购买IP；

(4) 企业2018、2019年未发生重大安全生产、环保等责任事故。

## 2、申报材料：

(1) 流片、IP费用补贴申请表（附件3）；

(2) 企业基本情况及流片、购置IP的相关情况报告；

(4) 企业经第三方审计机构出具的2018年审计报告

(6) 半导体投资促进中心委托第三方会计师事务所出具的流片及购买IP的专项审计报告并附上流片、IP费用明细表；

(7) 2018年企业参保人数证明等。

### (三) 鼓励引进集成电路研发人才（产业政策第15条）

(3) 2018年企业新招聘高层次人才、博士或正高职称、硕士或高级职称、毕业三年内“双一流”本科人

才（签订正式劳动合同并缴纳社会保险费）；

（1）人才补贴申报表（附件4）；

（2）企业基本情况及人才补贴相关情况报告；

（4）企业经第三方审计机构出具的2018年审计报告；（5）营业执照；

（6）高管个人劳动合同、社保缴纳证明（享受政策区间内持续在保）、学历证书文件等；

（7）2018年企业参保人数证明。

（四）鼓励集成电路企业做大做强（产业政策第19条）

（2）2018年企业参保人数原则上不少于10人；

（3）2018年度营业收入首次突破3000万元、5000万元、1亿元、5亿元、10亿元集成电路企业；

（4）企业已纳入规上工业或服务业企业统计范围；

（5）企业2018、2019年未发生重大安全生产、环保等责任事故。

2、申报要求：

（1）高层成长奖励申报表（附件5）；

（2）企业基本情况及产品相关情况报告；

（6）2018年度企业所得税汇算清缴表；

（五）支持企业与整机企业联动发展（产业政策第20条）

咨询电话：0551-65318129或187/5515/0066（微信同号）

（1）在合肥高新区依法从事集成电路设计为主营业务的企业，且经营场所、工商、税务、统计关系均在合肥高新区。

（3）企业自主开发的集成电路芯片首次被合肥市内整机企业（不限于集成电路产业链企业）采购；

（1）其他类申报表（附件6）；

（2）企业基本情况及企业所销售产品的情况说明；

（5）采购企业与被采购企业营业执照；

（6）交易双方企业股东信息的证明材料，申报企业及企业法人代表对交易双方企业无关联关系的承诺；

（7）2018年度内产品销售明细表，以及销售合同、发票及银行划款凭证（发票及银行划款凭证时间均需在申报时限内）；

（8）首次采购的证明（采购方和被采购方的共同出具的承诺函）；

(9) 2018年企业参保人数证明等。

(六) 鼓励集成电路设计企业贷款扩大研发(产业政策第22条)

(3) 企业2018年度为扩大研发、生产而新增的贷款;贷款资金已使用且已形成实物工作量;

(2) 企业基本情况及当年贷款资金为扩大研发、生产的情况说明(附相关图片)。

企业基本情况包括以下内容:

企业经营情况和发展目标〔企业简介,经营情况说明及相关财务报表(包括近三年企业销售收入、利润等),经税务部门核实盖章的纳税情况汇总表,相关税务票据,未来2-5年发展计划、目标和支撑措施等〕。

企业技术研发情况(包括研发平台建设、拥有核心自主知识产权情况及先进性、技术团队、企业主导产品在国内外细分行业领域的目前市场占有率等;并附技术先进性证明文件)。

(6) 贷款合同;

(7) 由半导体投资促进中心委托的会计师事务所出具的专项审计报告(包括贷款资金贷还明细,贷款资金用于扩大研发、生产的使用明细及对应产生的实物工作量等)。

四、其他

(一) 本政策与区财政其他同类政策不重复享受,获得“一事一议”政策支持的企业不得重复申报。

(二) 申报材料除申请表外,其他证明材料均提供复印件并加盖公章,原件现场审核后予以退回。